

【名稱】：SOP20 SO20 SOIC20 轉 DIP20、MSOP20 TSSOP20 轉 DIP20、  
QFN20 轉 DIP 支持 Pitch=0.65mm & 0.5mm

【型號】：MP2020QS2

【描述】：

- 板材：FR4 板材，板色：黑色，板層：2 層，板厚：1.6mm，銅厚：  
10Z，焊盤：採用化學沉金工藝（即焊盤表面特殊鍍金）
- 尺寸：25\*18\*1.6mm
- 用途：本轉接板適用於以下晶片封裝【①、Pitch（腳與腳間距）=1.27  
mm 的 SO20、SOIC20、SOP20；②、Pitch（腳與腳間距）=0.65mm 的 SSO  
P20、TSSOP20、MSOP20；③、Pitch（腳與腳間距）=0.65mm 的 QFN20；  
④、Pitch（腳與腳間距）=0.5mm 的 QFN20】
- 特點：可支援多個貼片封裝晶片轉外掛程式（但每個板一次只能焊接一  
個晶片轉外掛程式）

